



Eurocircuits - Standard Leiterplattenaufbau 0-8 Lagen

0 Lagen STD Aufbau 1.55mm 0.062"

Core	1550µm	62mil
-------------	---------------	--------------

1 Lagen STD Aufbau 1.55mm 0.062"

Core	1550µm	62mil
Kupfer - 1	35µm	1oz

2 Lagen STD Aufbau 1.55mm 0.062"

Kupfer - 1	18µm	½oz
Core	1550µm	62mil
Kupfer - 2	18µm	½oz

4 Lagen STD Aufbau 1.55mm 0.062"

Kupfer - 1	18µm	½oz
Prepreg 7628	180µm	7mil
Prepreg 7628	180µm	7mil
Kupfer - 2	35µm	1oz
Core	710µm	27.95mil
Kupfer - 3	35µm	1oz
Prepreg 7628	180µm	7mil
Prepreg 7628	180µm	7mil
Kupfer - 4	18µm	½oz

6 Lagen STD Aufbau 1.55mm 0.062"

Kupfer - 1	18µm	½oz
Prepreg 2125	100µm	4mil
Prepreg 2125	100µm	4mil
Kupfer - 2	35µm	1oz
Core	360µm	14.2mil
Kupfer - 3	35µm	1oz
Prepreg 7628	180µm	7mil
Prepreg 7628	180µm	7mil
Kupfer - 4	35µm	1oz
Core	360µm	14.2mil
Kupfer - 5	35µm	1oz
Prepreg 2125	100µm	4mil
Prepreg 2125	100µm	4mil
Kupfer - 6	18µm	½oz

8 Lagen STD Aufbau 1.55mm 0.062"

Kupfer - 1	18µm	½oz
Prepreg 2125	100µm	4mil
Prepreg 2125	100µm	4mil
Kupfer - 2	35µm	1oz
Core	200µm	8mil
Kupfer - 3	35µm	1oz
Prepreg 2125	100µm	4mil
Prepreg 2125	100µm	4mil
Kupfer - 4	35µm	1oz
Core	200µm	8mil
Kupfer - 5	35µm	1oz
Prepreg 2125	100µm	4mil
Prepreg 2125	100µm	4mil
Kupfer - 6	35µm	1oz
Core	200µm	8mil
Kupfer - 7	35µm	1oz
Prepreg 2125	100µm	4mil
Prepreg 2125	100µm	4mil
Kupfer - 8	18µm	½oz

Alle Materialien sind für bleifreies Löten geeignet.
Wir verwenden ausschließlich FR-4 improved als Material

Die Minima für die Hauptparameter des Materials sind: **Td >= 325 °C**
T260 >= 60 min
T288 >= 5 min
CTEz <= 3.7%
Tg >= 135°C

Alle verwendeten Materialien entsprechen den RoHS Vorschriften.